

## 公司概況資料表

以下資料由和亞智慧科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

- ④ 認購相關資訊
- ④ 公司簡介
- ④ 主要業務項目
- ④ 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
- ④ 最近五年度簡明資產負債表
- ④ 最近三年度財務比率

公司名稱：和亞智慧科技股份有限公司 (股票代號：7825)

董事長	石文機
總經理	陳志忠
資本額	新臺幣223,171,000元
輔導推薦證券商	群益金鼎證券股份有限公司 凱基證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	群益金鼎證券股份有限公司 聯絡人：塗先生 聯絡電話：(02)8789-8888#5159
註冊地國	該公司非屬外國發行人，故不適用
訴訟及非訟代理人	該公司非屬外國發行人，故不適用

輔導推薦證券商認購和亞智慧科技股份有限公司股票之相關資訊		
證券商名稱	主辦	協辦
		群益金鼎證券股份有限公司
認購日期	114年4月9日	
認購股數(股)	570,000	100,000
認購占擬櫃檯買賣 股份總數之比率	2.55%	0.45%
認購價格	每股新臺幣45元	

認購價格之訂定  
依據及方式

本推薦證券商參酌一般市場認購價格訂定方式，評估市價法、成本法及收益法等評價方式，以推算合理之股票價格，作為本推薦證券商認購和亞智慧科技股份有限公司(以下簡稱和亞智慧公司或該公司)興櫃股票價格之訂定依據；再參酌該公司產業概況、經營績效、發行市場環境及同業市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。

基於目前股票價值的評估方法諸多種類，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前市場上常用之股票評價方法主要包括：

- 1.市場法：本益比法及股價淨值比法皆係透過已公開資訊，與整體市場、產業性質相近同業及被評價公司歷史軌跡比較，以衡量企業價值，再依據被評價公司本身異於採樣公司部分作折溢價調整。
- 2.成本法：係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定基礎的淨值法。
- 3.收益法：未來淨收益或現金流量作為公司價值之評定基礎。

其中，成本法易忽略通貨膨脹因素且無法表達目前真正之經濟貢獻值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，可能低估成長型公司應有之價值；收益法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來淨收益或現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握；而市場法中的股價淨值法使用歷史性財務資料，無法反映公司未來成長性，且較常用於評估獲利波動度較大或有鉅額資產但股價偏低之公司，故本次推薦證券商認購和亞智慧公司股票茲就市場法之本益比法進行評估。

和亞智慧公司專注於以 AI (人工智慧) 技術為核心，結合光學影像檢測與智慧製造，提供高效能之智能解決方案，致力於提升製造業的生產效率與產品品質，產品主要應用於車用市場、半導體及 AR/VR 領域。經參酌目前上市(櫃)公司中營業項目、經營方式及營業規模等條件相近之公司，選取由田新技股份有限公司(上櫃公司，股票代號：3455，主要從事 PCB/IC 載板及 LCD 自動光學檢測設備研發、生產及銷售)、德律科技股份有限公司(上市公司，股票代號：3030，主要從事組裝電路板自動檢測設備及半導體檢測設備之研發、生產及銷售)及致茂電子股份有限公司(上市公司，股票代號：2360，主要以精密量測及「智」動化全方位解決方案從事量測儀器設備之研發、生產及銷售)作為採樣公司。

茲將其採樣同業、上市(櫃)其他電子業類股於113年12月至114年2月本益比列示如下：

單位：倍				
項目	113年12月	114年1月	114年2月	最近三個月平均
由田(3455)	23.96	23.02	23.54	23.51
德律(3030)	18.15	18.68	16.71	17.85
致茂(2360)	37.77	35.04	31.35	34.72
上市其他電子類	18.03	17.86	16.85	17.58
上櫃其他電子類	30.94	31.68	30.31	30.98

資料來源：證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站資料。

由上表得知，該公司之採樣上市(櫃)同業公司及上市(櫃)其他電子業類股最近三個月本益比區間為17.58~34.72倍，另經參閱和亞智慧公司113年度經會計師查核簽證之財務報告中之稅後淨利為60,216千元，並擬依興櫃掛牌股數22,317千股設算，每股稅後盈餘為2.70元，依上述本益比區間計算其參考價格為47.47元~93.74元。

經考量興櫃股票流通性風險及市場可能之折價率後，依前述價格之七折計算，其參考價格區間約為每股33.23元~65.62元。本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之本益比法計算該公司之合理價格，並考量該公司經營績效、產業前景、發行市場環境、同業之市場狀況及興櫃市場流動性不足之風險後等因素後，由興櫃推薦證券商與和亞智慧公司共同議定之每股45元之興櫃認購價格，尚屬合理。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)					
<p>一、公司介紹</p> <p>和亞智慧公司成立於民國104年6月，憑藉超過二十年光學影像處理及精密自動化的專業技術，提供客戶最佳的光學影像檢測系統整合方案。</p> <p>和亞智慧公司專精於AI圖像分析及光學檢測之技術研發，其中涵蓋了AI圖像演算法、光學視覺辨識技術，應用於相機影像檢測設備、3D感測檢測方案、半導體檢測方案及AI視覺辨識之客製化自動檢測設備方案等。隨著科技快速演進，人工智慧(AI)、自動化、智慧製造、半導體技術、光學檢測以及車用電子產業的發展趨勢正逐步改變市場競爭格局，秉持著持續創新與優化產品性能的理念，以因應全球市場需求的變化。</p>					
<p>二、歷史沿革</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">日期</th> <th>重要紀事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>104年6月</td> <td>公司成立於臺北市內湖，設立資本額為新臺幣26,000千元，定名為顛天光電股份有限公司</td> </tr> </tbody> </table>		日期	重要紀事	104年6月	公司成立於臺北市內湖，設立資本額為新臺幣26,000千元，定名為顛天光電股份有限公司
日期	重要紀事				
104年6月	公司成立於臺北市內湖，設立資本額為新臺幣26,000千元，定名為顛天光電股份有限公司				

105年8月	<p>辦理現金增資新臺幣10,300千元，增資後資本額為新臺幣36,300千元，銷售第一套 CCM 測試軟體並取得 HyVision 技術代理權擔任 CCM 模組測試軟體顧問、自動化公司的技術顧問</p> <p>開發銷售手機防手震(OIS)測試機</p> <p>開發銷售車載相機模組完整測試線</p> <p>開發銷售第一台MTF分選機、Lens單片組裝機</p>
106年5月	辦理現金增資新臺幣7,000千元，增資後資本額為新臺幣43,300千元
106年7月	<p>與相機模組測試設備廠(韓商 Hyvision)合作，並入股本公司</p> <p>打入日本松下供應鏈，成為第一家非日系供應商</p> <p>打入富士康供應鏈，出貨第一台廣角六軸Active Alignment機</p>
106年8月	辦理現金增資新臺幣11,400千元，增資後資本額為新臺幣54,700千元
107年2月	<p>辦理現金增資新臺幣19,800千元，增資後資本額為新臺幣74,500千元</p> <p>第一家與華為合作開發3D 結構光/TOF Tx &amp; Rx 檢測設備</p> <p>提供3D結構光模組完整檢測方案</p>
108年10月	<p>辦理現金增資新臺幣48,900千元，增資後資本額為新臺幣123,400千元</p> <p>知名大集團投資入股本公司，包括聯電、和碩、中華開發及迅得機械等</p> <p>進入和碩、光寶及富士康，成為台灣最大 IP CAM 影像檢測供應商</p> <p>推出 AI 技術應用於 PCB AVI 複檢</p>
109年5月	<p>進入車用模組大廠供應鏈</p> <p>推出 PCB 漲縮量測方案，並出貨國內一線 PCB 大廠</p> <p>推出 VCSEL 半導體檢測方案，並出貨一線封裝大廠</p>
110年6月	<p>辦理現金增資新臺幣76,600千元，增資後資本額為新臺幣200,000千元</p> <p>與台亞半導體進行策略合作，獲日亞化學集團旗下台亞半導體投資</p> <p>進入台亞半導體供應鏈</p> <p>導入智慧製造 SECS/GEM 升級方案</p> <p>推出半導體晶圓 AOI+AI 檢測設備</p>
111年6月	<p>辦理現金增資新臺幣20,000千元，增資後資本額為新臺幣220,000千元</p> <p>進入日商 Sharp 供應鏈</p> <p>推出 EDC 製程分析工具軟體 IDAS</p> <p>推出元宇宙 AR/VR 檢測方案</p>
112年6月	<p>打入美商供應鏈</p> <p>購置新竹台元科技園區第九期辦公室</p>
113年5月	新竹研發營運總部啟用
113年12月	員工認股權行使317,100股，增資後資本額為新臺幣223,171千元

### 三、經營理念

和亞智慧公司是以軟體為核心結合精密光學對位技術，打造業界差異化，以建立智慧製造及智慧工廠為目標，發展核心關鍵技術，以 AI 辨識及光學影像解決方案，成為世界級設計方案商。

目前業務涵蓋半導體、智慧製造、車用影像與元宇宙等領域，未來將持續開發新產品，擴展市場佔有率，並透過參加展覽提升品牌辨識度。此外，深化與現有客戶的合作，開拓新興產業應用，確保公司產品符合市場需求，增強客戶黏著度與市場影響力，並透過市場調查與數據分析，優化技術應用，確保產品品質與可靠性。建立完善的品質管理體系，確保產品在競爭激烈的市場中維持高標準。積極回應客戶需求，開發客製化解決方案，以靈活應對快速變動的產業趨勢，維持市場競爭優勢。

### 四、未來展望

#### (1)短期業務發展計劃

##### A.強化人工智慧技術應用

整合 AI 演算法與大數據分析技術，提升光學影像與視覺檢測系統的精準度，提高生產品質與良率。運用機器學習技術，自動識別與分類產品瑕疵，減少人為誤差。未來將持續開發創新應用，讓 AI 技術更深入製造流程，提高整體生產效能，推動智慧工廠發展。

##### B.拓展本地市場影響力

目前業務涵蓋半導體、智慧製造、車用影像與元宇宙等領域，未來將持續開發新產品，擴展市場佔有率，並透過參加展覽提升品牌辨識度。此外，深化與現有客戶的合作，開拓新興產業應用，確保公司產品符合市場需求，增強客戶黏著度與市場影響力。

##### C.提升產品品質與市場適應性

透過市場調查與數據分析，優化技術應用，確保產品品質與可靠性。建立完善的品質管理體系，確保產品在競爭激烈的市場中維持高標準。積極回應客戶需求，開發客製化解決方案，以靈活應對快速變動的產業趨勢，維持市場競爭優勢。

##### D.優化生產流程與彈性

建立模組化生產模式，提升供應鏈彈性與生產效率，確保能夠迅速適應市場變化。透過智能管理系統優化資源配置，縮短交期並降低成本。導入自動化生產技術，提高產品一致性與製造精度，滿足客戶對於產能及品質的高標準需求。

##### E.推動企業社會責任與永續發展

積極履行企業社會責任（CSR），推動環保與永續發展計畫，降低生產對環境的影響。關注 ESG（環境、社會、治理）議題，並透過支持教育與弱勢群

體展現企業關懷，建立符合國際標準的永續經營模式，使企業發展與社會責任並行。

## (2)中、長期業務發展計劃

### A.拓展國際市場

透過市場調研與戰略布局，擴展至美國、日本、大陸、東南亞與印度市場。建立全球業務團隊，加強與當地合作夥伴的聯繫，確保產品能順利進入各地市場。未來將持續投資海外據點，提升市場滲透率，強化企業全球競爭力。

### B.深化技術創新

持續推動研發，提升AI晶圓瑕疵檢測技術與3D AOI+AI影像檢測方案的精準度，提升產品競爭力。透過跨領域技術整合，開發高效能、高精度的檢測系統，確保技術持續創新與領先，符合半導體及光學產業的嚴格標準。

### C.強化產業合作與供應鏈整合

與全球主要半導體廠商深化合作，提升企業作為智慧製造與自動化檢測解決方案供應商的價值。強化供應鏈夥伴關係，確保技術與產品符合國際標準，提升市場競爭力，並拓展跨產業應用，鞏固企業在智慧製造領域的領導地位。

### D.強化人才培育與團隊建設

透過專業培訓計畫，提升員工技能與生產效率，確保企業擁有高素質的人才。完善薪酬與獎勵機制，提升員工滿意度與歸屬感。提供職涯發展機會，培養內部領導人才，打造穩健且具向心力的團隊。

### E.確保財務穩健與風險管理

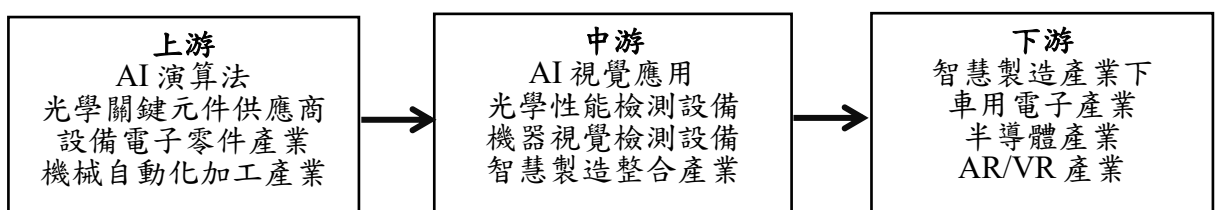
建立穩健的財務結構，確保營運資金充足，透過多元籌資方式降低企業風險。強化成本控制與收益管理，提升企業抗風險能力，確保長期發展的穩定性。未來將持續優化財務規劃，確保企業在市場變動中保持競爭優勢。

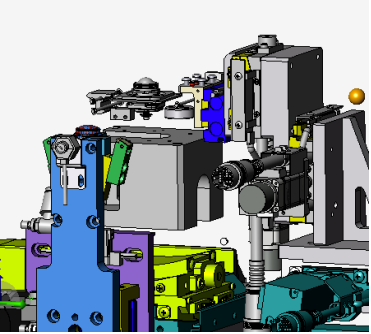

[TOP ^](#)

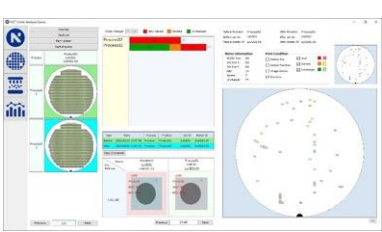
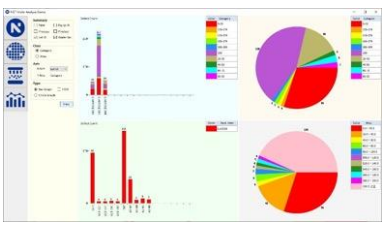
## 主要業務項目：

主要係從事自動化方案、軟體開發、技術勞務與系統整合。

## 公司所屬產業之上、中、下游結構圖：



產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額 (千元)	佔總營收 比重(%)
自動化方案		<p>高精度光學主動對位及影像品質檢測解決方案：</p> <p>透過高精度自動化模組，對光學模組進行 X、Y、Z、Pitch、Yaw 及 Roll 六個自由度的動態調整，確保所有光學元件精確對位，實現最佳光學校準，進而提升產品性能、良率及一致性，可應用於相機模組、AR/VR、光纖通訊及矽光子等領域。</p> <p>檢測相機模組或 AR/VR 設備的光學成像品質，如影像解析度、對比度、色彩準確度、畸變等，確保光學元件的組裝品質，提升產品可靠性及使用者體驗。</p>	132,607	46.95
		<p>半導體及自動光學檢測解決方案：</p> <p>透過高解析度相機與多光譜照明系統，結合先進影像處理技術，可對關鍵尺寸進行高精度量測，亦可應用於表面缺陷檢測，適用於晶圓表面缺陷檢測，例如刮痕、顆粒污染及刻蝕異常等。透過 AI 與深度學習技術，可進一步降低誤判率，提升檢測能力與準確性，確保產品品質與生產效率。</p>		

軟體、技術勞務及系統整合		AI 機器視覺利用影像分類、物件偵測、影像分割及異常偵測等技術應用於瑕疵檢測，以提高檢測準確度、提升生產效率並降低人力成本。	122,068	43.22
		AI 知識管理系統結合 LLM 技術，提供企業智慧客服、文件與知識管理及智慧決策支援，有效提升工作效率、降低營運成本並強化決策支持能力。		
	—	智慧製造整合工廠的所有感測器、機器、製程參數及測試數據，並結合 AI 數據分析，提供預防性保養預測及各製程與檢測資訊的關聯分析，幫助生產製程的應用參考，提高生產決策的準確性與效率。		
其他	—	設備的零件替換、耗材物品、維修技術勞務以及設備搭配的相關治具。	27,783	9.83
合計			282,458	100.00

TOP ^

### 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣

項目	年度	109年 (註1)	110年 (註1)	111年 (註1)	112年 (註1)	113年 (註1)	114年截至2月份止 (自結數)(註2)
營業收入		72,079	266,200	234,214	185,948	282,458	59,945
營業毛利		33,942	87,552	100,159	106,581	169,999	35,245
毛利率(%)		47.09	32.89	42.76	57.32	60.19	58.80
營業損益		(28,869)	5,648	4,764	6,817	49,180	13,253
營業外收入		1,544	5,106	9,617	17,845	22,941	2,232
營業外支出		(9,038)	(4,354)	(351)	(730)	(2,913)	(4,179)
稅前損益		(36,364)	6,400	14,030	23,932	69,208	11,306
稅後損益		(38,481)	3,217	16,825	26,531	60,216	10,399
每股盈餘		(3.12)	0.20	0.80	1.25	2.79	0.47

(元)							
發放	現金股利 (元)	—	—	0.2	0.2	1.0	—
	股票股利 (資本公積 轉增 資)(元)	—	—	—	—	—	—
	股票股利 (盈餘轉增 資)(元)	—	—	—	—	—	—

(註1)：109~113年度經會計師查核簽證之合併財務報告並採用國際財務報導準則編製。

(註2)：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

最近五年度簡明資產負債表						
單位：新臺幣						
項目	年度	109年	110年	111年	112年	113年
流動資產		181,509	407,677	644,597	523,196	561,726
基金及長期投資		1,910	1,910	1,910	1,910	318
固定資產		5,461	5,225	23,579	153,602	177,950
無形資產		2,420	1,501	637	661	1,230
其他資產		31,034	55,918	37,660	32,974	37,594
資產總額		222,334	472,231	708,383	712,343	778,818
流動 負債	分配前	110,389	217,210	430,318	254,396	289,152
	分配後	110,389	217,210	426,083	250,081	266,835
長期負債		8,976	10,769	8,438	135,857	121,687
其他負債		—	—	—	—	—
負債 總額	分配前	119,365	227,979	438,756	390,253	410,839
	分配後	119,365	227,979	434,521	385,938	388,522
股本		123,400	200,000	220,000	220,000	223,171
資本公積		92,966	123,606	64,216	64,751	69,139
保留 盈餘	分配前	(113,355)	(99,390)	16,861	39,884	96,958
	分配後	(113,355)	(99,390)	12,626	35,569	74,641
長期股權投資 未實現跌價損失		—	—	—	—	—
累積換算調整數		—	—	—	—	—
其他權益		(42)	20,036	(6,700)	10,205	(8,539)

### 最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣

年度		109年	110年	111年	112年	113年
項目						
庫藏股票		—	—	(24,750)	(12,750)	(12,750)
股東權益	分配前	102,969	244,252	269,627	322,090	367,979
總額	分配後	102,969	244,252	265,392	317,775	345,662

(註)：109~113年度經會計師查核簽證之合併財務報告並採用國際財務報導準則編製。

TOP ^

### 最近三年度財務比率

年度		111年	112年	113年
項目				
財務比率	毛利率(%)	42.76	57.32	60.19
	流動比率(%)	149.80	205.66	194.27
	應收帳款天數(天)	92.45	117.45	77.33
	存貨週轉天數(天)	175.02	347.26	244.95
	負債比率(%)	61.94	54.78	52.75

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)